

2024日本电子科技博览会-时间、地点

产品名称	2024日本电子科技博览会-时间、地点
公司名称	苏州京成展览有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本展会:2024
公司地址	苏州市花桥镇绿地杰作大厦9号楼1911室
联系电话	18913292209 18913292209

产品详情

2023NEPCON JAPAN日本电子科技博览会

【基本信息】

展会时间：2024年01月24-26日；东京Big Sight 展览馆

展会时间：2024年09月04-06日：东京千叶幕张展览馆

展会时间：2024年10月23-25日：名古屋展馆

展会规模：约1200家参展商； 参观人数：约50000名；

主办单位：励展博览集团日本株式会社

组展单位：上海贸升展览服务有限公司--日本展会服务商

【关于展览】

Nepcon Japan 2020 被认为是提供非常重要的机会的完美场所，因为参展商展示了新技术和产品，并为用户提供了zui新的创新。该展会将于2020年1月15日至17日在日本东京举行。该展会作为电子研发、设计和制造的国际展览会增加了其价值。此外，还增加了汽车电子、电动汽车和LED/OLED照明等前景广阔的应用展览，作为展示“电子的未来”zui新技术的场所而备受瞩目。由于近期来自中国、韩国和台湾的参展商和参观者数量的增长，该展会已成长为“代表亚洲电子行业的展览会”。

【展览范围】

电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN：贴片机、点胶机、焊接设备/材料、封装设备

、清洗设备、激光加工机、EMS/电子代工服务、清洁/静电防护器材、工厂/厂房设备

电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：各种检测设备、X射线检测设备、测试仪器、分离设备/软件、可靠性/评估检验设备、CCD相机、无损检测设备、合同分析服务

电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXPO：装配设备、包装材料/组件、IC封装分析/模拟软件、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO：接线器、线缆、传感器、接线端子、电源开关、电阻器、转换器、电路安装材料、纳米技术材料

印shua电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo：装配设备、保证材料/组件、IC封装分析/模拟软件、半导体器件/检测设备、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO:冲压加工、切削/钻孔、精密/微细钣金加工、金属成型、电铸、精密铸造、镜面磨削、镭射加工、模塑、难切削材料加工

支持服务

邀请piao优惠

我们将免费提供所需数量的邀请piao。您可以通过在展览前将他们发送到各地来鼓励客户参观。